

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2023-026

## 有研半导体硅材料股份公司 关于公司未受地震影响的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京时间2023年08月06日02点33分在山东省德州市平原县（北纬37.16度，东经116.34度）发生5.5级地震，震源深度10千米。有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）所在地山东省德州市经济开发区，距离震源较近。鉴于部分投资者关注地震给公司带来的影响，公告说明如下：

经核实，截至目前公司不存在人员伤亡和重大财产损失的情况，生产经营情况正常。此次地震未对公司及控股子公司山东有研半导体生产经营及未来发展造成影响，感谢社会各界对公司的关心。

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023年8月7日